

東京エレクトロンの事業概要

半導体製造装置

パソコン、携帯電話など、デジタル製品の基幹部品である半導体デバイス(ICチップ)。その生産を担う半導体製造装置を幅広く取り揃え、世界の半導体メーカーに、優れた技術サポートとともに提供しています。

ウエーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、そして、ウエーハテスト工程で使われるウエーハプローバの6製品群をラインアップ。製品の多くが世界市場でトップシェアを獲得しています。

主要取扱い製品

- コータ/デベロッパ
- プラズマエッチング装置
層間絶縁膜エッチング装置・シリコンエッチング装置
- 熱処理成膜装置
- 枚葉成膜装置
CVD装置・プラズマ処理装置
- 洗浄装置
オートウェットステーション・枚葉洗浄装置
ブリククリーン装置・スクラバーシステム
- ウエーハプローバ
- 輸入製品



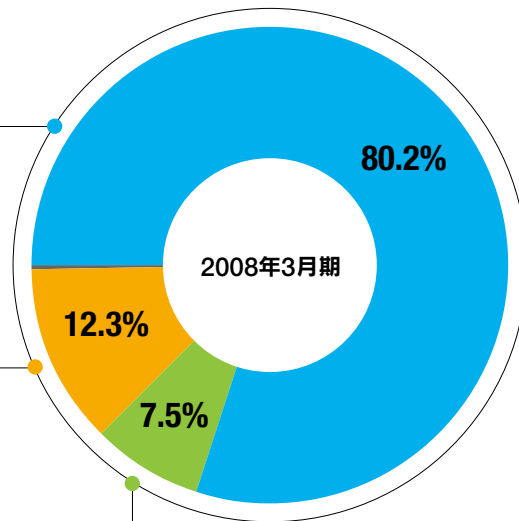
コータ/デベロッパ
CLEAN TRACK® LITHIUS Pro™



熱処理成膜装置
TELINDY PLUS™



オートウェットステーション
EXPEDIUS®+



電子部品・情報通信機器

世界の優れた電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器などを多彩に取り揃え販売を行う「商社ビジネス」と、お客さまのニーズに応えて設計開発や自社ブランド商品の開発を行う「開発ビジネス」の二つの機能を有する、新しい形態のビジネスを展開しています。東京エレクトロンデバイス(株)が当ビジネスのオペレーションを行います。

主要取扱い製品

- 半導体製品
- コンピュータ・ネットワーク機器
- ソフトウェア
- その他電子部品



東京エレクトロンデバイス(株)開発の
inrevium™

FPD製造装置

美しく鮮やかな映像を映し出すパソコンや液晶テレビのディスプレイ。その生産を担うFPD(フラット・パネル・ディスプレイ)製造装置を、液晶パネルメーカーに、確かな技術サポートとともに提供しています。

製品ラインアップは、FPDコータ/デベロッパとFPDプラズマエッチング/アッシング装置。大型液晶テレビの普及に伴い、装置の基板サイズも年々大型化に向かっていきます。

主要取扱い製品

- FPDコータ/デベロッパ
- FPDプラズマエッチング/アッシング装置



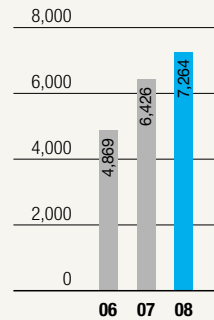
FPDプラズマエッチング/アッシング装置
Impressio®

半導体製造装置

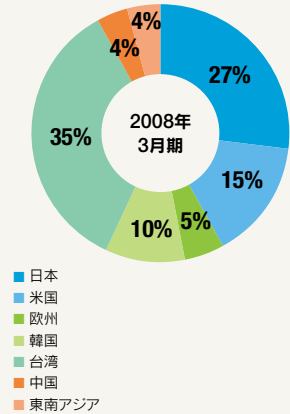
2008年3月期概要

- 事業環境：期の前半は半導体メモリ製品を中心に設備投資が活況を呈したが、後半、需給バランスの悪化とともに顧客である半導体メーカーの投資意欲が後退した
- 売上高：前期比13.0%増加の7,264億円
- 台湾向け売上が前期比79.8%増と大きく伸び、次いで、日本向けも9.2%増と高い伸びを示した
- ウェーブローバを除く全製品で売上が前期を上回った
- 期の前半より受注が調整期に入り、年間を通しての受注額は前期比37.0%減少の5,041億円となった

売上高
(億円)



地域別売上高構成比

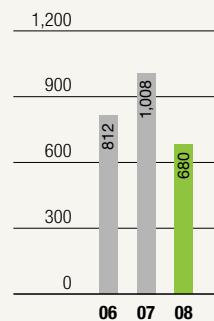


FPD製造装置

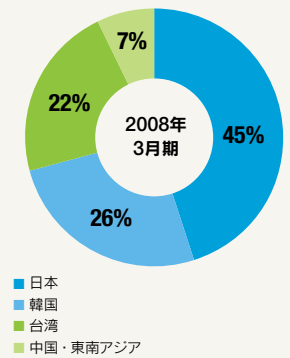
2008年3月期概要

- 事業環境：2006年後半からのパネルの需給バランス悪化の影響で、低調な設備投資となった
- 売上高：前期比32.5%減少の680億円
- 台湾向け売上が前期比63.1%の大幅減少となった
- 大型基板向けの第7,第8世代が売上の中心となった
- パネル需給バランスが下半期から改善に向かうとともに受注も回復し、通期受注額は前期比94.2%増加の1,299億円となった

売上高
(億円)



地域別売上高構成比

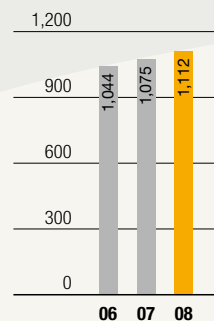


電子部品・情報通信機器

2008年3月期概要

- 事業環境：期の後半から国内経済の景況感悪化に伴い、半導体市場はやや減速に向かったが、企業における情報セキュリティや内部統制関連の法整備を背景にIT投資は堅調だった
- 売上高：前期比3.5%増加の1,112億円
- 売上の7割以上を占める「半導体製品」分野においては、高付加価値デバイスの販売に注力するとともに、半導体受託設計業務の拡大と自社商品「インレピアム」の開発強化に注力した

売上高
(億円)



地域別売上高構成比

